

## IMS-Leiterplatten (Isolated Metall Substrates) und Substrate zur Verwendung für Power Elektronik, LED- und Laser Applikationen

Gerne senden wir Ihnen detaillierte Daten zu dem jeweiligen Material zu. Die Oberflächen-Metallisierung kann je nach Bedarf realisieren werden.

Bezeichn- ung	Material	Wärmeleitfähigkeit	Metallisier- ung	Oberfläche	Größe	Dicke	bonden	löten
IMS	Polyimide - PI	0,18 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	12,5 - 125 um	JA	JA
IMS	FR4 - Prepeg	0,30 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	100 - 3000 um	JA	JA
IMS	91ML 120 um	1.0 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	120 um	JA	JA
IMS	92ML 120 um	2.0 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	120 um	JA	JA
IMS	85 um / 110 um	2.0 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	85 / 110 um	JA	JA
IMS	VT4A1 105 um	1.6 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	105 um	JA	JA
IMS	VT4A2 110 um	2.2 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	110 um	JA	JA
IMS	85 um / 110 um	2.2 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	85 / 110 um	JA	JA
IMS	100 um	2.0 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	100 um	JA	JA
IMS	100 um	2.0 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	100 um	JA	JA
IMS	100 - 300 um	3.0 w/mk	Cu	HASL; OSP, chem. Sb; Chem. NiAu,	600 x 500 mm	100 - 300 um	JA	JA
DCB	Al2O3	24 w/mk	Cu	NiAu	177 x 127 mm	0,63 + 300umCu	JA	JA
DCB	AlN	130-180 w/mk	Cu	NiAu	190 x 190 mm	0,63 + 300umCu	JA	JA
AgENIG	Al2O3	25 w/mk	Ag	chemisch Ni+ immersion Au	170 x 127 mm	0,25-2,0 mm + .....	JA	JA
AgENIG	AlN	170-230 w/mk	Ag	chemisch Ni+ immersion Au	170 x 127 mm	0,25-2,0 mm + .....	JA	JA
PCTF	Al2O3	25 w/mk	Ag	CuNiAu	170 x 127 mm	0,25-2,0 mm + .....	JA	JA
PCTF	AlN	170-230 w/mk	Ag	CiNiAu	170 x 127 mm	0,25-2,0 mm + .....	JA	JA
MMC	AL-DIA 400	440-480 w /mk	Al	Al	250 x 250 mm	1 - 20 mm	NEIN	NEIN
MMC	AL-DIA 500	580 w/mk	Al	Al	250 x 250 mm	1 - 20 mm	NEIN	NEIN
MMC	Cu-Dia 300	330 w / mk	Cu	Cu / NiAu	250 x 250 mm	1 - 20 mm	JA	JA
MMC	Cu-Dia 500	540 w / mk	Cu	Cu / NiAu	250 x 250 mm	1 - 20 mm	JA	JA
MMC	Cu-Dia 600	620 w / mk	Cu	Cu / NiAu	250 x 250 mm	1 - 20 mm	JA	JA
MMC	Ag-Dia 500	550 w / mk	Ag	Ag	250 x 250 mm	1 - 20 mm	JA	JA

\*\* Wird bevorzugt für LED-Module verwendet im Moment

\*\* Hier handelt es sich um ein neues Material für extreme Wärmeableitung